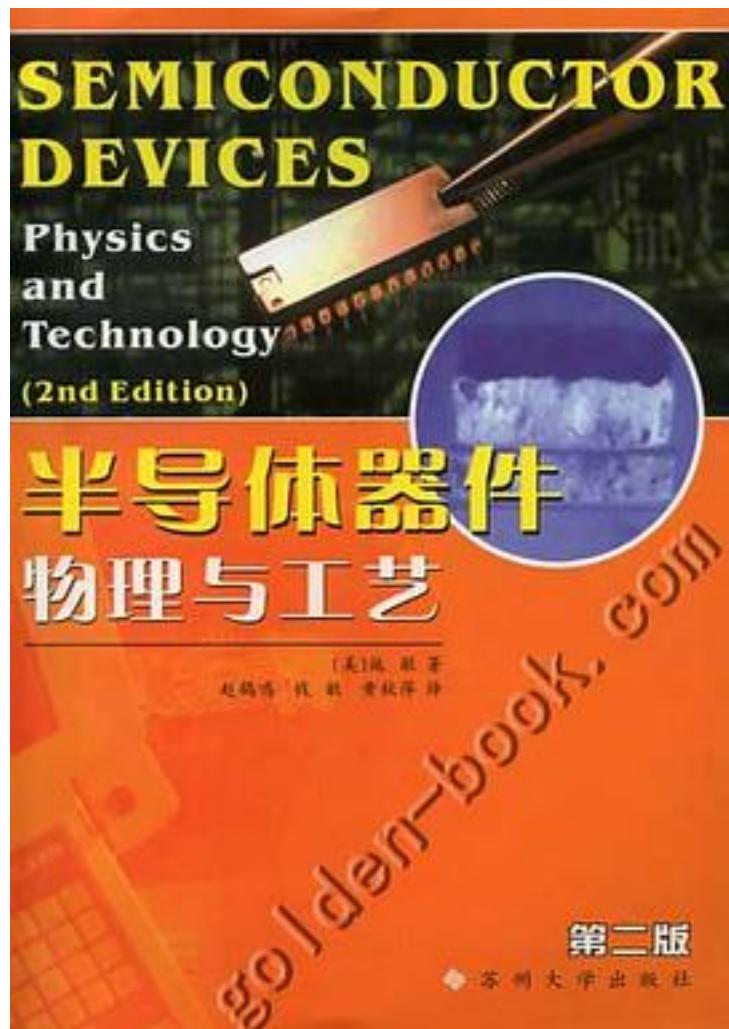


半导体器件物理与工艺



[半导体器件物理与工艺 下载链接1](#)

著者:

出版者:

出版时间:1970-1

装帧:

isbn:9787811373080

《半导体器件物理与工艺(基础版)》内容简介：微电子学及其相关技术的迅速发展，现

已成为整个信息时代的标志与基础。以半导体器件为核心的电子工业，已发展成为世界上规模最大的工业。培养该专业及相关的专业人才相当重要。施敏教授所著《半导体器件物理与工艺(第二版)》的简体中文版自出版以来，被多所院校相关专业选为本科生和研究生教材，深受使用者的喜爱，得到使用院校极高的评价，现已四次重印。随着职业教育的发展，不少职业院校也开设了半导体、微电子技术、集成电路应用等专业。《半导体器件物理与工艺(基础版)》就是在《半导体器件物理与工艺(第二版)》的基础上，为了适应职业教育的培养目标和职业院校学生实际知识水平而修订改编的。

全书分为三个部分：第1部分半导体物理，描述半导体的基本特性和它的传导过程，尤其着重在硅和砷化镓两种最重要的半导体材料上。第2部分半导体器件，讨论主要半导体器件的物理过程和特性。由对大部分半导体器件而言最关键的p-n结开始，介绍双极型和场效应器件、热电子和光电子器件、微波及量子器件等。第3部分半导体工艺，介绍从晶体生长到掺杂等工艺技术的各个主要步骤，并特别强调其在集成电路上的应用。

作者介绍：

目录：

[半导体器件物理与工艺 下载链接1](#)

标签

半导体物理

评论

[半导体器件物理与工艺 下载链接1](#)

书评

[半导体器件物理与工艺 下载链接1](#)